



本社：〒160-8366
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20120629000A
2012 年 7 月 23 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタマドキュメント
マネージャ 牧 達郎 

PWR SOP (7DUA/10DVS)/PDIP (7NVA/10NVE) パッケージ 一部製品 組立部材変更のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しく願い申し上げます。

今回のお知らせは、変更実施についての連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

お客様におかれましては、本通知発行日後、**30** 日以内に通知確認のご連絡をお願いいたします。また、30 日以内にご連絡が無い場合には、本変更をご承認いただけただけのものとして判断させていただきます。変更品評価用サンプルもしくは追加データご入用の場合には、本通知発行日後 30 日以内にご依頼をお願いいたします。

変更品の出荷につきましては、お客様との早期変更実施の個別契約を締結している場合を除いては、本通知発行日より **90** 日以降に予定いたしております。この通知期間は、弊社品質標準に基づいております。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではございません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはございません。

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いは pcn_tij@list.ti.com にお問い合わせ下さい。

以上

変更概要

通知タイプ	<input type="checkbox"/> Initial notice (Plan)	<input checked="" type="checkbox"/> Final notice		
変更概要	Design/Specification	<input type="checkbox"/> Design	<input type="checkbox"/> Electrical	<input type="checkbox"/> Mechanical
	Wafer Fab	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	Wafer Bump	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	<input checked="" type="checkbox"/> Assembly	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input checked="" type="checkbox"/> Material
	Test	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	
	Others	<input type="checkbox"/> Packing/Shipping/Labeling		<input type="checkbox"/> -
変更内容	PWR SOP (7DUA/10DVS)/PDIP (7NVA/10NVE) パッケージ 一部製品 組立部材変更 現行 : Polyimide Coat Inductor Insulation 変更後 : Parylene Coat Inductor Insulation			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	11月上旬の出荷より予定しています。			
品質認定試験	<input checked="" type="checkbox"/> 計画	<input type="checkbox"/> 終了		
製品表示	<input checked="" type="checkbox"/> 変更無し	<input type="checkbox"/> 変更あり		
備考	—			

変更内容

内容 : 弊社 PWR (パワーマネジメント) SOP (7DUA/10DVS)/PDIP (7NVA/10NVE) パッケージ 一部製品の Inductor Insulation 部材について、現行 Polyimide Coat を使用して製造していますが、パッケージ吸湿による高温リフロー時クラック防止の為に、これに替えて、Parylene Coat に変更します。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差)、外観、動作特性、品質、信頼性への影響はありません。

<u>変更内容</u>	<u>現行</u>	<u>変更後</u>
Inductor Insulation部材	Polyimide Coat	Parylene Coat

理由 : パッケージ吸湿による高温リフロー時クラック防止の為

詳細 : Polyimide coating inductor コアは、吸湿した場合、高温リフロー時にパッケージクラックを発生する場合があります。Parylene coating は、非常に薄く、吸湿しません。

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

対象製品リスト

対象製品名				
DCP010505BP	DCP010512DBP-U/700	DCP020503P	DCR011205P	DCV010514CP-U
DCP010505BP-U	DCP010512P-U-7	DCP020505P	DCR012403P	DCV010514CP-U/700
DCP010505BP-U/700	DCP010515BP	DCP020507P	DCR012405P	DCV010514CP-U/7E4
DCP010505BP-U/7E4	DCP010515BP-U	DCP020509P	DCR021205P	DCV010515DP
DCP010505BP-UE4	DCP010515BP-U/700	DCP020515DP	DCR021205P-U	DCV010515DP-U
DCP010505DBP	DCP010515DBP	DCP021205P	DCR022405P	DCV010515P
DCP010505DBP-U	DCP010515DBP-U	DCP021205PE4	DCR022405P-U	DCV010515P-U
DCP010505DBP-U/700	DCP010515DBP-U/700	DCP021207P-U-7	DCR022405P-U/700	DCV011512DP
DCP010505DBP-U/7E4	DCP011512DBP	DCP021207P-U-7/700	DCV010505DP	DCV011512DP-U
DCP010505DBP-UE4	DCP011512DBP-U	DCP021212DP	DCV010505DP-U	DCV011512DP-U/700
DCP010507DBPE4	DCP011512DBP-U/700	DCP021212P	DCV010505P	DCV011515DP
DCP010507DBP-U/7E4	DCP011515DBP	DCP021515P	DCV010505P-U	DCV011515DP-U
DCP010507DBP-UE4	DCP011515DBP-U	DCP021515PE4	DCV010505P-U/700	DCV011515DP-U/700
DCP010512BP	DCP011515DBP-U/700	DCP022405DP	DCV010505P-U/700E4	DCV012405P
DCP010512BP-U	DCP012405BP	DCP022405P	DCV010512DP	DCV012405P-U
DCP010512BP-U/700	DCP012405BP-U	DCP022415DP	DCV010512DP-U	DCV012405P-U/700
DCP010512DBP	DCP012415DBP	DCR010503P	DCV010512DP-U/700	DCV012415DP
DCP010512DBPE4	DCP012415DBP-U	DCR010505P	DCV010512P	DCV012415DP-U
DCP010512DBP-U	DCP012415DBP-U/700	DCR011203P	DCV010512P-U	DCV012415DP-U/700

信頼性試験

信頼性試験計画

信頼性試験期間	開始	2012年3月	終了	2012年8月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
ID:	Device1	Device2	Device3	
Qual Device:	DCP010505BP	DCP010512DBP	DCR010505P	
Assembly Site:	HNT	HNT	HNT	
Package/Code/Pins:	PDIP/NVA/7	PDIP/NVA/7	PDIP/NVE/10	
Mount Compound:	400018	400018	400018	
Mold Compound:	450260	450260	450260	
Bond Wire:	1.2 Mil Dia., Au	1.2 Mil Dia., Au	1.2 Mil Dia., Au	
Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	NiPdAu, Cu	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-3/260C	JEDEC L-3/260C	JEDEC L-3/260C	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		Device1	Device2	Device3
**Steady-state Life Test	100C, 168, 500, 1000 Hrs	77	-	-
**T/C	-40C/125C, 250, 500, 1000 Cyc	77	77	77
Manufacturability (Assembly)	per mfg. Site specification	per spec	per spec	per spec
Moisture Sensitivity	JEDEC L-3/260C	12	12	24
Note: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-3/260C.				